



Tak Cheong Industrial Zone, Bubian, Shanwei Guangdong, PRC.

初始产品/流程变动通知

APCN 编号: PCN-08-012
分布日期: Dec. 1st 2008

主题: 评估和鉴定镀锡电镀线重新布局

描述与目的:

德昌为了提高管理效率, 减少对环境污染, 决定合并各车间的电镀生产线统一集中于的电镀车间, 因此我们在没有对电镀溶液和流程参数做任何改变的前提下, 需要对新转移镀锡地点的电镀线进行评估与鉴定。

我们的计划如下:

- 1 电镀线从现在的贴片组装车间搬迁至新电镀车间, 其流程和设备不做任何更改。
2 评估的产品为贴片二极管
3 评估结果有完整的在线测试良率和焊锡性及锡厚度测试结果, 并且其结果是可比的。

受变动影响产品清单:

小信号封装(Mini-melf & Melf) 和 SOD87 封装及其产品类型

若你对此变动有任何疑问, 请联系

QA 工程师: 杨凯

Weber.yang@takcheong.com

备注: 如果在签发日的 30 天内没有收到客户的反对意见,那么汕尾德昌电子有限公司在签发日的 30 天后认为此次改变被批准。

批准人:

Manufacturing Manager:

QA Service Manager:

Manufacturing QA Manager:

Business Development Manager: